

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2024-028

宝鼎科技股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”或“公司”）于2024年4月10日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年计提商誉减值准备的议案》，同意对公司收购山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）62.54%股权时所形成的商誉计提减值准备15,524.52万元。具体情况如下：

一、本次计提商誉减值准备概述

（一）商誉的形成

2022年4月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司以119,735.75万元购买招远永裕电子材料有限公司、山东招金集团有限公司等13名交易对方持有的金宝电子63.87%股权，以发行102,689,322股股份方式支付全部交易对价，评估基准日为2021年8月31日，标的资产过户日为2022年9月6日。宝鼎科技对金宝电子本次收购形成24,686.07万元商誉。计算过程如下：

项目	山东金宝电子有限公司（万元）
合并（购买）成本	119,735.75
减：取得的可辨认净资产公允价值	148,813.19
按持股比例63.87%	95,049.68
商誉（合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额）	24,686.07

根据《企业会计准则第8号—资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号-商誉减值》的有关规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年商誉均结合与其相关的资产组进行减值测试。

(二)本次计提商誉减值准备的原因

金宝电子是一家专业从事电子铜箔、覆铜板设计、研发、生产及销售的高新技术企业。2023年，受宏观经济下行及行业周期因素和终端客户去库存因素影响，叠加地缘政治冲突导致的国内企业与国际供应链联系减弱影响，国内手机、电脑、家电等消费类电子产品终端市场需求下滑，2023年度国内铜箔、覆铜板行业订单不足，标的公司主要产品铜箔、覆铜板销量未达预期。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2024]0011002672号），截止2023年12月31日，金宝电子实现的净利润数4,615.30万元，扣除非经常性损益后的净利润为4,317.22万元，业绩承诺完成率为20.75%，未能实现2023年度承诺的业绩。公司董事会根据2023年度业绩承诺完成情况以及对未来经营情况进行分析预测后，谨慎判断公司收购金宝电子63.87%股权（2023年3月金宝电子增资后降为62.54%）形成的商誉存在较大的减值风险。

(三)商誉减值的测试情况

为客观评价相关资产组价值，公司聘请北京中同华资产评估有限公司以2023年12月31日为评估基准日对公司收购金宝电子62.54%股权形成的商誉进行减值测试，并出具了《宝鼎科技股份有限公司拟商誉减值测试涉及的因并购山东金宝电子有限公司形成与商誉相关的资产组可收回金额评估项目资产评估报告》（中同华评报字[2024]第040529号）。经过评估人员测算，该资产组（CGU）的预计未来现金流量的现值为169,000.00万元，因此含商誉资产组（CGU）可收回金额为169,000.00万元。

截至2023年12月31日，金宝电子含商誉资产组账面价值为195,166.91万元，金宝电子含商誉资产组减值26,166.91万元，2022年度计提商誉减值准备840.27万元，2023年度公司收购金宝电子62.54%股权形成的商誉计提减值准备金额15,524.52万元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次计提商誉减值准备15,524.52万元，影响2023年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少15,524.52万元，相应减少2023年度归属于上市公司股东的所有者权益15,524.52万元。

三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理，计提商誉减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果。董事会同意本次计提商誉减值准备。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：监事会认为公司董事会审议《关于 2023 年计提商誉减值准备的议案》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则，此次计提商誉减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 11 日